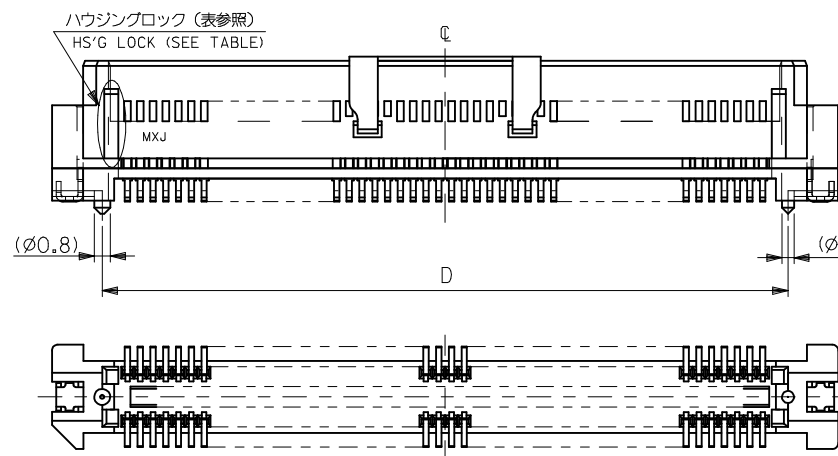
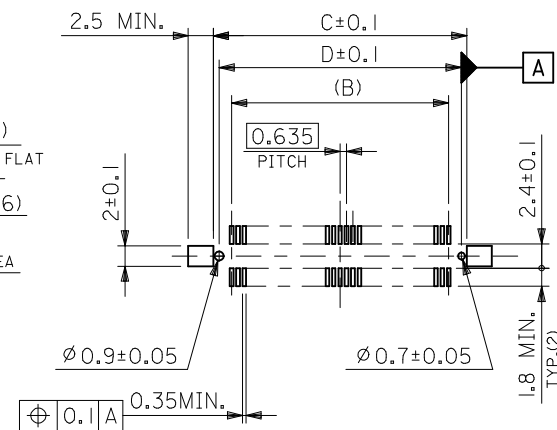




注)
NOTES

1. 材質

MATERIAL
ハウジング：ガラス入りPPS、茶色、UL94V-0
HOUSING:G.F.PPS,BROWN,UL94V-0
ターミナル：銅合金（ $t = 0.2$ ）
TERMINAL:COPPER ALLOY
吸着カバー：ステンレス（ $t = 0.2$ ）
VACUUM COVER:STAINLESS STEEL

2. メッキ仕様 PLATING

接点部 : 金メッキ 0.25 μ m MIN.
CONTACT AREA : GOLD 0.25 MICROMETER MIN.
半田付け部 : 錫メッキ 1.0 μ m MIN.
SOLDER TAIL AREA : TIN 1.0 MICROMETER MIN.
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.5 μ m MIN.
UNDER-PLATING : NICKEL 1.5 MICROMETER MIN.

3. テールのバラツキ寸法

テール平坦度は、0.1 MAX.とする。
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1MAX.

4. 本製品は 53647-***2 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53647-***2.

材料 MATERIAL	注) 参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注) 参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —
被覆外径 INS. RANGE	— # —

REVISED EC NO: J2017-0269 DRAWINGS CHKD: APPR:MSASAO 2016/12/01 2016/12/26	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) 0.25 UNDER 0.25 OVER 0.5 UNDER 0.5 OVER 1.0 UNDER 0 OVER 10 UNDER 10 OVER 30 UNDER 30 OVER ± ± ± ±0.2 ±0.25 ±0.3	DIMENSION STYLE MM ONLY	SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
	REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
			DRAWN BY Y. WADA	DATE '04/02/27	TITLE 0.635 PITCH B-TO-B PLUG HS'G COVER ASS'Y -LEAD FREE-		
			CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/27	molex		
			APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/27	DOCUMENT NO. SD-53647-002		
			MATERIAL NO.	SHEET NO. 1 OF 1			
			SEE CHART				